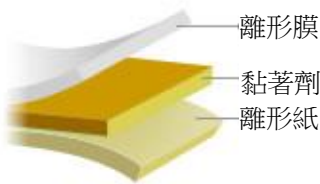


FPC D3410系列熱固膠帶

特點

- 可於FR4補強板或PI補強板呈現極佳的黏合強度。
- 低溫短時間固化，可縮短加工時間。
- 適合儲存於室溫環境中。
- 具初期微黏性，易於定位。
- 適用於各種加工程序，例如，傳壓機或真空快壓機及後續熟化。

結構



| | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| 產品名稱 | D3410 | D3411 |
| 主要成份 | NBR/環氧樹脂 | NBR/環氧樹脂 |
| 基材 | 無基材 | 無基材 |
| 顏色 | 淡黃色 | 淡黃色 |
| 黏著劑厚度 (μm) | 約35 | 約25 |
| 離形膜厚度 (μm) | 約38 | 約38 |
| 離形紙厚度 (μm) | 約115 | 約110 |
| 接著強度 (N/10mm) * | 20 | 14 |
| 標準尺寸 (寬度及長度) | 500mm x 100M | 500mm x100M |

* 90°剝離強度 (被貼物 :CCL/PI)

<建議壓著條件>

■真空快壓+熟化

壓合溫度：130~160℃

壓合時間：真空10~30 秒>壓合1~2分鐘

壓力：1.5~2.0 MPa

熟化條件：140℃、60 min

■傳壓機：

壓合溫度：160℃

壓合時間：60 min

壓力：3 MPa

適用用途

■適用於需經Reflow的FPC其補強板之固定用。

注意事項

①烘乾程序

建議過Reflow前最好先進行烘乾處理，以防止爆板問題。

建議條件：：100℃x60 min以上

②樣品在過Reflow前的放置條件：23℃x65%RH, 3hr以內



技術性資料

1.對各被貼物之接著強度（90°剝離）

<測試件條件>

被貼物：Glass Epoxy/Polyimide

膠帶寬度：10mm

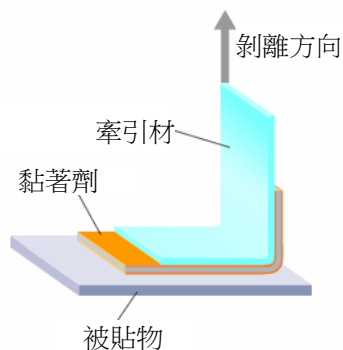
壓合條件：建議壓著條件

量測環境：23℃±5℃，60%±20%RH

剝離速度：50mm/min

牽引材：CCL（含銅箔）

〔量測前先在室溫下放置1hr〕



<90°剝離強度測試>

<結果>

(N/10mm)

| 90°剝離強度 | | D3410 | D3411 |
|---------|--------|-------|-------|
| 傳壓機壓合 | CCL/GE | 21 | 17 |
| | CCL/PI | 15 | 13 |
| 真空快壓+熟化 | CCL/GE | 20 | 17 |
| | CCL/PI | 20 | 14 |

2. 耐Reflow特性

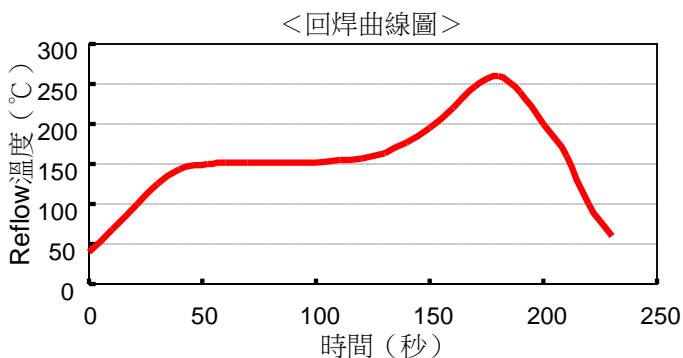
<樣品製作條件>

被貼物：Polyimide film/CCL

壓合條件：建議壓著條件

Reflow條件：最高至260℃（請參照回焊曲線圖）

量測環境：23℃±5℃，60%±20%RH



<實驗結果> *Reflow後進行外觀確認

| 壓合條件 | 預烘乾條件* | D3410 | D3411 |
|---------|---------|-------|-------|
| 傳壓機壓合 | 1/100/- | 無異狀 | 無異狀 |
| 真空快壓+熟化 | 1/100/- | 無異狀 | 無異狀 |

※處理時間（H）／溫度（℃）／溼度（%）

附註

- D3410系列的溢膠量，會隨著補強板之厚度、尺寸及形狀而不同，使用前請先進行確認。特別是在有開孔的補強板上使用時必須特別注意。

修版日期：2013年9月

特性資料附註：本型錄所述之產品特性資料，係根據本公司之評估結果而制訂，但不保證這些產品特性將符合使用環境之所需。因此，使用前應根據設備及底層所提供之評估資料而檢視相關之用途情況。

Dexerials Corporation

URL : <http://www.dexerials.jp/en/>

總公司：Gate City Osaki, East Tower 8th floor, 1-11-2 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 141-0032（日本東京）

業務及行銷部門／電話：+81-3-5435-3946